技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 第三届中国创新挑战赛（上海）组委会 | | | 机构代码 | |  | |
| 区 域 | | |  | 联系人 | 唐旭东 | | 电话 | | 13917662089 |
| 行业领域 | | |  | | | 产业领域 | |  | |
| 经济规模 | | |  | | | 人员规模 | |  | |
| **需求信息** | | | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ■技术研发（关键、核心技术）  ■产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 公司研发生产测试探针，半导体测试探针，射频测试探针，射频模块，连接器等产品。在产品研发过程中，对产品的电镀技术提出新的要求，寻求专家解决。 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  公司研发生产测试探针，半导体测试探针，射频测试探针，射频模块，连接器等产品。在产品研发过程中，对产品的电镀技术提出新的要求，寻求专家解决。  电镀技术要求： 1.超精密电镀技术，0.15mm内径通孔电镀。 2.高碳钢材料电镀技术，要求表面光滑。 3.类颜色处理的更为光亮，以及材料表面的光洁度处理。 | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  迫切性：长期有效  完成时间:无  预算金额：面谈 | | | | | | |
| 产学研合作需求 | 需求  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发  ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 ■其他 无 | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ■是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ■是  □否 | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ■是  □否 | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ■否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | |